



2024年11月1日

各 位

会 社 名 ザインエレクトロニクス株式会社  
代表者の役職名 代表取締役社長 南 洋 一 郎  
(スタンダード・コード番号：6769)  
問い合わせ先 取締役総務部長 山 本 武 男  
電 話 番 号 0 3 - 5 2 1 7 - 6 6 6 0

## 新中期経営戦略「Innovate100」策定のお知らせ

～革新的ソリューション提供を通じて AI 社会実装加速と経済社会の生産性向上に貢献し、  
企業グループ売上高 100 億円超を目指す～

当社グループは 2027 年 12 月期を目標年次とする 2025 年度からの中期経営戦略「Innovate100」を策定しましたので、お知らせいたします。目標年次である 2027 年度に売上高 100 億円超を実現することを目標といたします。なお、次期中期経営戦略の目標を達成した場合、当社グループの投下資本利益率 (ROIC) は 10% 超に達するものと見込んでおります。

### 1. 新中期経営戦略「Innovate100」策定の目的

当社グループは、2022 年度より 2024 年度を目標年次とする中期経営戦略「5G&Beyond-NE」の下、コロナ禍等の事業環境変化を踏まえた新成長ユースケースを開拓し、スマート・コネクティビティによるソリューションの提供を通じた戦略 5 ゴールの目標に取り組んで参りました。その結果、①DX-IoT の社会実装加速に向け配線集約可能な革新的な半導体新商品を量産開始するとともに②AI/IoT に不可欠な通信基盤となる通信モジュール等を大口顧客向けに展開し、お客様の現場であるエッジ側とクラウドを接続する無線通信ソリューションを車載市場、自動販売機市場等にも拡充したほか、クラウド側の計算資源を提供するサーバー事業を開始しました。さらに、③車載市場においてカメラ向けおよびディスプレイ向け高速情報伝送用半導体新商品を量産適用、④医療市場において世界初 4K 使い捨て内視鏡等への画像処理用半導体等を量産適用、⑤Beyond5G 時代に向けた光通信用半導体技術 (超低消費電力、超低レイテンシー)および超高速情報伝送技術を確立、などにより、戦略 5 ゴール実現に向けた所要の成果を得ることができました。

来期から開始する中期経営戦略「Innovate100」においては、これまで確立した差別化力および半導体、AI/IoT ソリューション、AI サーバー等から成る事業ポートフォリオを活かしつつ、今後の経済社会において AI 活用ユースケースの適用加速に寄与する革新的なソリューションを提供することにより、経済社会の生産性向上への貢献に取り組んで参ります。

### 2. 中期経営戦略「Innovate100」の概要

#### (1) 基本戦略

当社グループは、“Interface to the Future - Solution by Smart Connectivity-” をベースに差別化力と新たな付加価値を通じて継続的に社会に貢献して参ります。

主要各国での労働人口が減少し高齢化が進展する中、生成 AI を含めた AI の社会実装を進めることは生産性向上を実現する上で最も重要な鍵と見込まれ、AI の社会実装による生産性向上が経済社会の成長・発展に有意なインパクトを与えることが期待されます。一方で、その前提となるデータセンターの計算量は飛躍的に拡大し、その消費電力が課題になると懸念されます。

こうした環境の下、当社グループとして半導体、AI/IoT ソリューション、AI サーバーから成る 3 事業を通じて AI 社会実装の加速とともに、光半導体を通じてデータセンター消費電力の拡大抑制に貢献していく方針です。

さらに、AI 社会実装の一層の加速に資するコラボレーションやアライアンスを一層重視し、M&A やパートナー企業との win-win 協業の機会をさらに強力に模索して参ります。

## (2) 経営目標

次期中期経営戦略「Innovate100」目標年次である 2027 年度において、売上高 100 億円超を目指します。

なお、次期中期経営戦略の目標を達成した場合、当社グループの投下資本利益率 (ROIC) は、10%超に達するものと見込んでおります。

## (3) 具体的取り組み

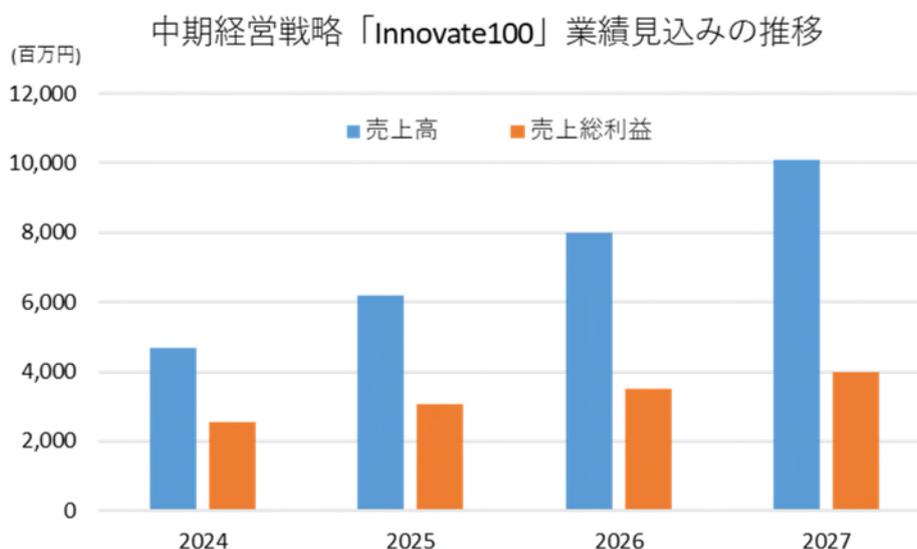
次期中期経営戦略「Innovate100」においては既存のお客様に強力なサポートと新しい付加価値を継続的に提供することに加え、半導体、AI/IoT ソリューション、AI サーバー等から成る 3 事業により、以下に代表される取り組みを図ってまいります。

- ・ AI プロセッサ搭載ソリューションビジネス立上げ  
(V-by-One®技術および Qualcomm 製 AI プロセッサユニット搭載スマートモジュール活用)
- ・ DX-IoT 向け配線集約用半導体の大規模適用
- ・ EdgeAI-Link®によるエッジ AI ソリューションなどの DX 支援事業の開始
- ・ 光半導体 (独自の DSP レス技術による超低消費電力、超低レイテンシー) の商品化
- ・ AI センシングの起点となるスマートメーターに向けた無線通信事業展開
- ・ 車載機器・産機器における機器とクラウドを連携する無線通信ソリューションの適用加速
- ・ 通信キャリア向けビジネス展開
- ・ AI サーバー等サーバー事業・保守事業の拡販加速

## (4) 半導体、AI/IoT ソリューション、AI サーバー等から成る 3 事業間のシナジー強化

当社グループは半導体、AI/IoT ソリューション、AI サーバー等から成る 3 事業間でのシナジーを一層強化するため、新たなソリューション開発、仕入先または販売先との関係を活用した価値の拡大などに積極的に取り組んで参ります。

また、この一環として、本日別途開示したとおり、次期中期経営戦略の実施に合わせて、当社グループの AI/IoT 中核企業であるキャセイ・トライテック株式会社の社名を 2025 年 7 月 1 日付で「ザイン・モバイルテック株式会社」に変更し、3 事業全てにおいてザイン (THine) ブランドのシナジーを活かした革新的ソリューションを通じて社会に貢献して参ります。



※「EdgeAI-Link」、「V-by-One」はザインエレクトロニクス株式会社の登録商標です。

**【注記事項】**

本資料における予想値及び将来の見通しに関する記述・言明は、弊社が現在入手可能な情報による判断及び仮定に基づいております。その判断や仮定に内在する不確実性及び事業運営や内外の状況変化により、実際に生じる結果が予測内容とは実質的に異なる可能性があることを予めご了承ください。弊社は将来予測に関するいかなる内容についても、その確実性を保証するものではありません。

以上